

A1

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



G00002

(43) 国際公開日
2003 年 3 月 20 日 (20.03.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/023087 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C23C 18/20, C08J 7/06 (74) 代理人: 古谷 馨, 外(FURUYA, Kaoru et al.); 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-17-8 浜町花長ビル6階 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP02/09231
- (22) 国際出願日: 2002 年 9 月 10 日 (10.09.2002) (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2001-274447 2001 年 9 月 11 日 (11.09.2001) JP
特願 2001-363109
2001 年 11 月 28 日 (28.11.2001) JP
特願2002-100768 2002 年 4 月 3 日 (03.04.2002) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ダイセルポリマー株式会社 (DAICEL POLYMER LTD.) [JP/JP]: 〒100-6077 東京都千代田区霞が関3-2-5 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田井 利弘 (TAI, Toshihiro) [JP/JP]: 〒591-8001 大阪府堺市常盤町1-1-2-520 Osaka (JP) 外崎 一平 (TONOSAKI, Ippei) [JP/JP]: 〒597-0062 大阪府貝塚市澤1090-503 Osaka (JP).
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PLATED RESIN MOLDING AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: メッキ樹脂成形体とその製造方法

(57) Abstract: A process for producing a plated resin molding by plating the surface of a thermoplastic resin molding with a metal, which satisfies any of the following requirements (1), (2), and (3): (1) the thermoplastic resin molding comprises a thermoplastic resin and a water-soluble substance and the process includes the step of degreasing the resin molding and the step of electroless plating and does not include the step of etching with an acid containing a heavy metal; (2) the thermoplastic resin molding comprises a polyamide resin and a styrene resin and the process includes the step of degreasing the resin molding and the step of electroless plating and does not include the step of etching with an acid containing a heavy metal; and (3) the process includes as a pretreatment for a metal plating step, a step in which the thermoplastic resin molding is treated by contact with an acid or base containing no heavy metals. Also provided is a plated resin molding obtained by the process. In the plated resin molding, the deposit layer has high adhesion strength although etching with chromic acid was not conducted.

[続葉有]

WO 03/023087 A1

162162